

低温実装

Low-temperature mounting

優れた線材加工技術と、低温用フラックスの開発で低温実装を実現

Our superior wire-processing technology and the development of flux enabled the low-temperature mounting

特長

- 省エネと実装コストの低減を実現した、ソルダペースト LT142
- 独自の伸線技術で、業界初のSn-Bi系やに入りはんだ、LEOを開発
- 耐落下衝撃性に優れた、はんだ合金L27を開発

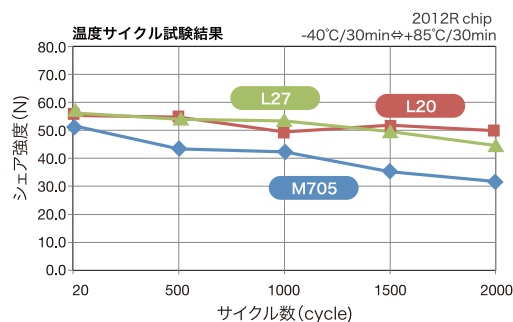


仕様

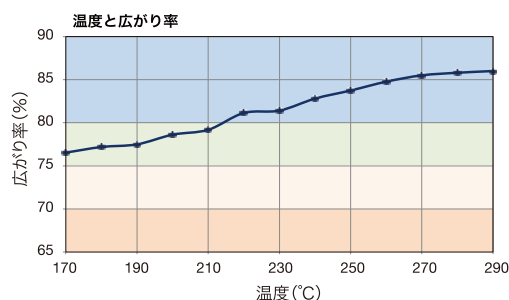
- 基板温度200℃でも、はんだ付けが可能です



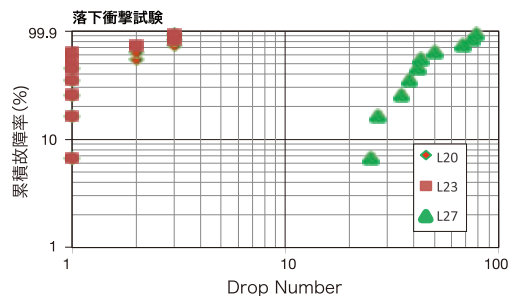
- 耐熱疲労特性に優れたSn-Bi系はんだ



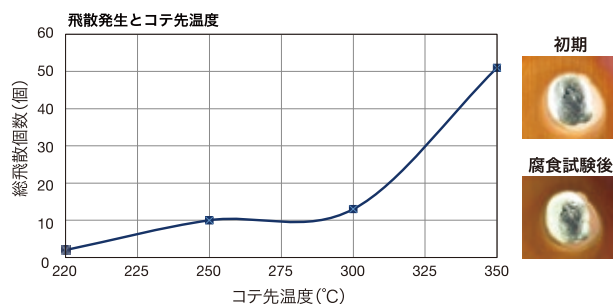
- LEOは低温域から良好な濡れ広がりを示します



- 耐落下衝撃性に優れたL27-LT142



- 低温専用フラックスLEOの開発で、低飛散と良好な耐腐食性を実現



- Sn-Bi系はんだによる低温短時間実装で、50%以上の省エネを実現

